

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一五年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2015年5月15日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一五年三月三十一日止三個月未經審核的綜合經營業績。

二零一五年第一季度经营业绩

- 二零一五年第一季度銷售額同比增加12.5%至1.661億美元，環比持平。
- 二零一五年第一季度毛利率增至30.5%，高於上季度的29.1%及去年同期的25.5%。
- 二零一五年第一季度淨利潤達到2,480萬美元，環比增加29.3%，同比增加22.3%。

二零一五年第二季度指引

- 我們預期第二季度銷售收入目標環比增長2%左右。
- 此外，我們預期毛利率將與上季度持平。

“二零一五年第一季度，華虹半導體持續受益於來自我們所專注的技術領域的強勁勢頭，並由此獲得了如下業績亮點：

- 二零一五年第一季度的產能利用率上升至 96.1%，主要來自於對智能卡和分立器件的強勁需求。
- 銷售額達到 1.661 億美元，使得本季度成為我們歷史上同期業績最突出的季度之一。
- 中國區域的銷售收入占總銷售額的比例上升到 56.5%，主要來自於智能卡和分立器件的強勁需求。
- 從技術平臺角度，嵌入式非易失性存儲器產品的銷售額依然穩定，占我們總銷售額比例的 39.8%，分立器件銷售額占比增加至 20.9%，大部份來自於對超級結 MOSFET 產品的需求增長。
- 由於產能利用率的增長，毛利率增長至 30.5%。

我們繼續看好未來全球半導體市場，尤其是中國市場。我們相信我們的戰略正在收穫成效。公司正在按計劃全速推進產能擴充，與此同時，技術研發也按計劃進行，並符合客戶的需求。我們致力於為我們的股東實現價值。”華虹半導體總裁兼執行董事王煜先生表示。

電話會議公告

日期：二零一五年五月十八日

時間：上海時間上午十時

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

<https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~q42014earningscall>

電話：	國際	+61 283 733 610
	中國	+86 800 870 0210 +86 400 120 3170
	香港	+852 3051 2792
	臺灣	+886 2 7743 8419
	美國	+1 845 507 1610
	新加坡	+65 3158 0667

電話會議登入名：**76205018**

密碼：**HUAHONG**

該電話會議廣播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿廣播後 6 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

二零一五年第一季度經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運資料除外)

	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第一季度 (未經審核)	同比
銷售收入	166,088	166,129	-	147,575	12.5 %
銷售成本	(115,364)	(117,730)	(2.0)%	(109,916)	5.0 %
毛利	50,724	48,399	4.8 %	37,659	34.7 %
毛利率	30.5%	29.1%		25.5%	
經營開支	(23,793)	(26,045)	(8.6)%	(16,386)	45.2 %
其他收入淨額	5,630	3,038	85.3 %	4,923	14.4 %
稅前溢利	32,561	25,392	28.2 %	26,196	24.3 %
所得稅開支	(7,795)	(6,240)	24.9 %	(5,945)	31.1 %
期內溢利	24,766	19,152	29.3 %	20,251	22.3 %
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	24,766	19,152	29.3%	20,251	22.3 %
非控制權益	-	-	-	-	-
持有人應佔每股盈利					
基本	0.02	0.02	-	0.03	(33.3)%
攤薄	0.02	0.02	-	0.03	(33.3)%
付運晶圓(仟片)	351	343	2.3%	310	13.2%
產能利用率 ¹	96.1%	93.3%	2.8%	86.3%	9.8%

- 二零一五年第一季度銷售額為 1.661 億美元，環比持平，同比增加 12.5%。
- 二零一五年第一季度銷售成本為 1.154 億美元，比上季度的 1.177 億美元下降 2.0%。
- 二零一五年第一季度的毛利率為 30.5%，較上季度的 29.1%上升了 1.4 個百分點，主要由於客戶需求強勁以及產能利用率的上升。
- 二零一五年第一季度經營開支為 2,380 萬美元，比上季度的 2,600 萬美元下降了 8.6%，主要是由於上季度發生了一次性的首次公開募股費用。
- 二零一五年第一季度的期內溢利增至 2,480 萬美元，相比上季度的 1,920 萬美元上升了 29.3%。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

按類別劃分的銷售收入分析

	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第一季度 (未經審核)
晶圓	96.9%	95.7%	97.1%
其他	3.1%	4.3%	2.9%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 二零一五年第一季度，96.9%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

按地域劃分的銷售收入分析

	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第一季度 (未經審核)
中國 ²	56.5%	52.6%	54.3%
美國	18.5%	19.1%	18.2%
亞洲 ³	8.5%	10.3%	10.6%
歐洲	8.8%	9.5%	9.6%
日本 ⁴	7.7%	8.5%	7.3%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 中國區域在二零一五年第一季度仍是我們最大的市場，其貢獻的銷售收入佔我們總銷售額的56.5%，相比上季度的52.6%增加了3.9個百分點，主要得益於客戶對我們電可擦可編程只讀存儲器及超級結 MOSFET 產品的強勁需求。

按技術平臺劃分的銷售收入分析

	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第一季度 (未經審核)
嵌入式非易失性存儲器	39.8%	42.5%	39.9%
分立器	20.9%	19.3%	19.9%
模擬與電源管理	15.5%	14.7%	11.3%
邏輯及射頻	11.8%	12.5%	18.0%
獨立非易失性存儲器	10.9%	9.4%	10.0%
其他	1.1%	1.6%	0.9%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 二零一五年第一季度，來自嵌入式非易失性存儲器產品的銷售額佔總銷售額的39.8%，比上季度的42.5%下降2.7個百分點，主要由於美國與臺灣市場對微控制器產品需求的減少。同時，分立器產品的銷售額增長至佔總銷售額的20.9%，比上季度的19.3%上升了1.6個百分點，主要來自中國客戶對超級結 MOSFET 產品的需求增長。

² 包括香港。

³ 不包括中國及日本。

⁴ 包括於2013年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

按工藝技術節點劃分的銷售收入分析

	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第一季度 (未經審核)
0.13 μm 及以下	37.1%	40.7%	37.1%
0.15 μm 及 0.18 μm	16.9%	18.5%	24.1%
0.25 μm	1.1%	0.6%	0.7%
0.35 μm 及以上	44.9%	40.2%	38.1%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 來自 0.13 μm 及以下工藝技術節點產品的收入占二零一五年第一季度總銷售額的 37.1%，環比下降了 3.6 個百分點。這部份銷售額的下降被來自 0.35 μm 及以上工藝技術節點產品收入所彌補，其占二零一五年第一季度總銷售額的 44.9%，環比上升了 4.7 個百分點，主要由於分立器及電可擦可編程只讀存儲器的需求強勁增長。

按終端市場分佈劃分的銷售收入分析

	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第一季度 (未經審核)
電子消費品	51.6%	53.9%	48.7%
通訊	26.7%	23.9%	29.2%
工業及汽車	13.2%	12.4%	13.4%
計算機	8.5%	9.8%	8.7%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 電子消費品及通訊仍分別為我們最大及第二大的終端市場分佈，這兩類市場在二零一五年第一季度合計貢獻的銷售額占我們總銷售額的 75% 以上。

產能⁵及產能利用率

晶圓廠 (仟片晶圓每月)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	50	50	50
2 號晶圓廠	39	39	34
3 號晶圓廠	40	40	40
總估計月產能	129	129	124
產能利用率	96.1%	93.3%	86.3%

- 二零一五年第一季度，我們的產能為每月 12.9 萬片 200mm 晶圓。二零一五年第一季度的產能利用率從上季度的 93.3% 上升至 96.1%，主要由於客戶需求增長所驅動。

⁵ 期末每月可製造晶圓片數，且為了可比，以 30 天計。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一五年	二零一四年	環比	二零一四年	同比
	第一季度 (未經審核)	第四季度 (未經審核)		第一季度 (未經審核)	
付運晶圓	351	343	2.3%	310	13.3%

- 二零一五年第一季度的付運晶圓達到 351 仟片，相比上季度的 343 仟片，環比上升了 2.3%。

經營開支分析

以千美元計	二零一五年	二零一四年	環比	二零一四年	同比
	第一季度 (未經審核)	第四季度 (未經審核)		第一季度 (未經審核)	
銷售及分銷費用	1,803	2,085	(13.5)%	1,601	12.6 %
管理費用 ⁶	21,990	23,960	(8.2)%	14,785	48.7 %
經營開支	23,793	26,045	(8.6)%	16,386	45.2 %

- 二零一五年第一季度的經營開支環比下降 8.6%，主要由於上季度發生了一次性的首次公開募股費用。
- 二零一五年第一季度的經營開支同比上升 45.2%，主要是由於用人費用和研發費用的增長。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一五年	二零一四年	環比	二零一四年	同比
	第一季度 (未經審核)	第四季度 (未經審核)		第一季度 (未經審核)	
租金收入	3,191	3,695	(13.6)%	3,133	1.9 %
利息收入	1,701	1,247	36.4%	1,069	59.1 %
分佔一家聯營公司溢利	1,208	17	7005.9%	4,503	(73.2)%
財務費用	(2,210)	(2,638)	(16.2)%	(3,519)	(37.2)%
其他	1,740	717	142.7%	(263)	(761.6)%
其他收入淨額	5,630	3,038	85.3%	4,923	14.4 %

- 二零一五年第一季度其他收入淨額環比上升 85.3%，主要由於 (i) 確認了聯營公司在第一季度出售房地產的溢利，(ii) 利息收入的增加，(iii) 利息支出的減少，以及 (iv) 匯兌收益的增加。

⁶管理費用包括確認為研發開支抵消項目的政府補助。

現金流量概要

以千美元計	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第一季度 (未經審核)	同比
經營活動所得現金流量淨額	33,561	89,987	(62.7)%	22,754	47.5%
投資活動所用現金流量淨額	(116,647)	(21,448)	443.9%	(35,328)	230.2%
融資活動所得(用)現金流量淨額	(2,196)	235,834	(100.9)%	(3,287)	(33.2)%
外匯匯率變動影響淨額	(2,114)	1	(211500.0)%	(3,365)	(37.2)%
現金及現金等價物增加淨額	(87,396)	304,374	(128.7)%	19,226	(554.6)%

- 由於銷售額的增長，經營活動所得現金流量淨額從二零一四年第一季度的 2,280 萬美元增長至二零一五年第一季度的 3,360 萬美元。但環比低於上季度的 9,000 萬美元，主要是因為 (i) 二零一五年第一季度發放了上年年終獎金，(ii) 二零一四年第四季度包含從關聯方預收的房屋租金，以及 (iii) 二零一四年第四季度收回了較多的應收賬款，主要由於前幾個季度的較高銷售額。
- 二零一五年第一季度投資活動所用的現金流量淨額為 1.166 億美元，其中 8,180 萬美元是為定期存款，3,480 萬美元為設備投資支出。
- 二零一五年第一季度融資活動所用現金流量淨額為 220 萬美元，為向銀行支付的貸款利息。

流動性概述 (以千美元計)

	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)
存貨	91,604	93,988
貿易應收款項及應收票據	111,054	107,509
預付款項、按金及其他應收款項	8,506	7,254
應收關聯方款項	43,152	41,402
已抵押存款及定期存款	92,389	2,583
現金及現金等價物	559,377	646,773
流動資產總額	906,082	899,509
貿易應付款項	58,729	65,258
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	68,636	70,357
計息銀行及其他借款	81,543	81,690
政府補助	65,722	64,367
應付關聯方款項	21,508	24,883
應付所得稅	27,529	23,311
流動負債總額	323,667	329,866
淨營運資金	582,415	569,643
速動比率	2.5x	2.4x
流動比率	2.8x	2.7x

- 二零一五年第一季度末的存貨由上季度末的 9,400 萬美元減少至 9,160 萬美元，主要是由於在產品庫存的減少，部份被原材料庫存增長所抵消。
- 二零一五年第一季度末的已抵押存款及定期存款由上季度末的 260 萬美元增長至 9,240 萬美元，主要由於一部份現金存為定期存款。也正由於這個原因，現金及現金等價物從上季度末的 6.468 億美元減少至 5.594 億美元。
- 二零一五年第一季度末的貿易應付款項為 5,870 萬美元，與上季度末的 6,530 萬美元相比有所減少，主要因為在本季度增加了對供應商付款。
- 二零一五年第一季度末的其他應付款、預收賬款及暫估費用由上季度末的 7,040 萬美元減少至 6,860 萬美元，是因為本季度支付了上年年終獎金。
- 二零一五年第一季度末的應收關聯方款項由上季度末的 2,490 萬美元減少至 2,150 萬美元，主要由於對一家關聯方的房租預收款，部份確認為第一季度的房租收入。
- 二零一五年第一季度末應付所得稅由上季度末的 2,330 萬美元增至 2,750 萬美元，是因為計提了二零一五年第一季度的所得稅。
- 二零一五年第一季度末的淨營運資金為 5.824 億美金，流動比率為 2.8，相比上季度末為 5.696 億美金，流動比率為 2.7。

資本結構 (以千美元計)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)
現金及現金等價物	559,377	646,773
已抵押存款及定期存款	92,389	2,583
短期計息銀行借款	81,543	81,690
長期計息銀行借款	182,875	183,031
銀行借款總額	264,418	264,721
權益	1,485,433	1,465,336
資本負債比率 ⁷	(26.1)%	(26.2)%

資本開支概要

- 二零一五年第一季度資本開支為 3,480 萬美元，較上季度的 2,140 萬美元增加 62.6%，主要由於產能擴充的原因。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

⁷ (銀行借款 - 現金及現金等價物以及已抵押存款及定期存款) / 總權益

華虹半導體有限公司
綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月	
	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)
銷售收入	166,088	166,129
銷售成本	(115,364)	(117,730)
毛利	50,724	48,399
其他收入及收益	6,641	7,681
投資物業的公平值收益	-	1
銷售及分銷費用	(1,803)	(2,085)
管理費用	(21,990)	(23,960)
其他費用	(9)	(2,023)
財務費用	(2,210)	(2,638)
分佔一家聯營公司溢利	1,208	17
稅前溢利	32,561	25,392
所得稅開支	(7,795)	(6,240)
期內溢利	24,766	19,152
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	24,766	19,152
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.02	0.02
攤薄	0.02	0.02
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	996,584,265
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	996,584,265

華虹半導體有限公司
綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至	
	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	558,894	569,136
投資物業	190,809	190,821
預付土地租賃款項	23,923	24,194
無形資產	13,606	15,330
於聯營公司的投資	43,079	43,281
可供出售投資	229,641	230,512
長期預付款項	31,872	8,237
遞延稅項資產	8,637	9,182
非流動資產總額	1,100,461	1,090,693
流動資產		
存貨	91,604	93,988
貿易應收款項及應收票據	111,054	107,509
預付款項、按金及其他應收款項	8,506	7,254
應收關聯方款項	43,152	41,402
已抵押存款及定期存款	92,389	2,583
現金及現金等價物	559,377	646,773
流動資產總額	906,082	899,509
流動負債		
貿易應付款項	58,729	65,258
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	68,636	70,357
計息銀行及其他借款	81,543	81,690
政府補助	65,722	64,367
應付關聯方款項	21,508	24,883
應付所得稅	27,529	23,311
流動負債總額	323,667	329,866
流動資產淨額	582,415	569,643
總資產減流動負債	1,682,876	1,660,336
非流動負債		
計息銀行及其他借款	182,875	183,031
遞延稅項負債	14,568	11,969
非流動負債總額	197,443	195,000
淨資產	1,485,433	1,465,336
權益和負債權益		
股本	1,550,164	1,550,164
儲備	(64,731)	(84,828)
權益總額	1,485,433	1,465,336

華虹半導體有限公司
綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	於三月三十一日	於十二月三十一日
	二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
經營活動所得現金流量		
稅前溢利	32,560	25,392
折舊及攤銷	19,844	21,616
應佔聯營公司溢利	(1,208)	(17)
營運資金的變動及其它	(17,635)	42,996
經營活動所得現金流量淨額	33,561	89,987
投資活動所得現金流量:		
購置物業、廠房及設備項目	(34,764)	(21,448)
其他投資活動(所用)的現金流量	(81,883)	-
投資活動所用現金流量淨額	(116,647)	(21,448)
融資活動所得現金流量:		
公開發行股份收到款項	-	320,150
償還銀行貸款	-	(81,711)
已付利息	(2,196)	(2,605)
融資活動所得(用)現金流量淨額	(2,196)	235,834
現金及現金等價物增加淨額	(85,282)	304,373
外匯匯率變動影響淨額	(2,114)	1
期初現金及現金等價物	646,773	342,399
期末現金及現金等價物	559,377	646,773

承董事會命
華虹半導體有限公司
傅文彪
董事長兼執行董事

中國 香港
二零一五年五月十五日

於本公告日期，本公司董事分別為:

執行董事

傅文彪(董事長)
王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚